

要求仕様書

品名: 6 インチシリコンウエハ

1.組成、成分情報

成分	CAS 番号	含有量(wt%)
シリコン	7440-21-3	99.999

2.納入規格

•結晶規格

項目	規格	単位	分析・測定方法	位置	頻度
製法	CZ	—	—	—	—
導電型(ドーパント)	P(Boron)	—	PN 判定器	中心	1 回/Lot
結晶面方位	<100>±2.0	°	カット面 X 線分析装置	中心	1 枚/Lot
抵抗率	5~20	Ω・cm	抵抗率測定機	中心	10%抜取

•加工規格

項目	規格	単位	分析・測定方法	位置	頻度
直径	150.0±0.2	mm	ノギス	直径	1 枚/Lot
厚さ	625±25	μm	非接触厚さ計	中心	全数
OF 方位	[110]±2.0	°	カット面 X 線分析装置	—	1 枚/Lot
OF 長さ	47.5±2.5	mm	ノギス	—	1 枚/Lot
面取り	倣い面取り	—	—	—	—
TTV	≤3	μm	平坦度測定機	面内 EE5mm	全数
LTV	≤1 ※セルサイズ 15X15mm	μm	平坦度測定機	面内 EE5mm	全数
そり	≤30	μm	平坦度測定機	面内 EE5mm	全数
重金属汚染	≤1X10 ¹¹ (Fe・Ni・Cu・Cr)	atoms/cm ²	ICP-MS 定量分析	全面	1 枚/Lot
裏面光沢度	10~150	%	光沢度計	中心	2 枚/Lot
表面仕上げ	CMP (ケミカルメカニカエル ポリッシュ)	—	—	—	—
裏面仕上げ	エッチド	—	—	—	—

•外観規格

項目	表面規格(CMP 側)	裏面規格(エッチド 面)	測定方法	頻度
マクロクラッチ	目視にて認められないこと	目視にて認められないこと	目視	全数
マイクロクラッチ	累計長さ≤Dia/10	—	目視	全数
カケ	中心方向: ≥0.3mm 円周方向: ≥0.3mm 個数: ≤0 ケ/枚	—	目視	全数
エッジチップ	中心方向: ≤0.5mm 円周方向: ≤0.8mm 個数: ≤3 ケ/枚 (但し、中心方向又は円周方向の長さが 0.3mm 未満は個数に数えない。)	—	目視	全数
クラック、クロ-トラック、 汚れ、クモリ、ピンホール、ピット、 オレンジピール	目視にて認められないこと	—	目視	全数
パーティクル	≥0.2/μm ≥30 ケ/枚 EE5mm	—	パーティクル カ ウンター	全数